

tesa® HAF 8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



HAF फिल्मติดด้วยการกระตุ้นด้วยความร้อน สามารถนำไฟฟ้าได้ในแกน z สี่ชั้นหนา 40 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® HAF 8414 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน โปร่งแสง ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนเดียว
- สามารถใช้งานได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด (DI)
- เหมาะกับพื้นผิว silver ink (RFID)

เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานของอนุภาค: 40 ไมครอน

การใช้งาน

tesa® HAF 8414 ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มีความเสถียรและการเชื่อมติดที่ทนทาน การใช้งานหลักคือการฝังชิพในการ์ดแบบ Dual Interface (DI) และ strap attachment สำหรับ RFID tag

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	none	• ประเภทของแผ่นลอก	glassine
• ประเภทของกาว	copolyamide	• สี	โปร่งแสง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- แรงยึดเกาะ (ผลึก) 7 N/mm²

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด วัสดุ antenna ชิปโมดูลและรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า เวลาการติดขึ้นอยู่กับกำลังความร้อนของพื้นผิววัสดุที่ใช้ นอกจากนั้น เราขอแนะนำขั้นตอนการทำให้เย็นตัวลงโดยตรงหลังจากขั้นตอนการติด ควรใช้แรงกดจนอุณหภูมิฟิล์มลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิที่ทำให้ร้อนตัว (ประมาณ 110 °C)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของเครื่อง

1. การเคลือบติดเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล การเคลือบที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ HAF 8414 เพื่อให้แน่ใจในการยึดเกาะที่ดีและค่าการนำไฟฟ้าที่ดีภายในขั้นตอนสุดท้าย

tesa® HAF 8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 130 - 150 °C
- แรงกดทับ 1.5 - 3 บาร์
- เวลา 1 - 2.5 ม./นาท.

2. การติดตัวนำไฟฟ้า:

ระหว่างการฝังโมดูล โมดูลที่ถูกติดเทปไว้เบื้องต้นจะถูก die-cut

จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าในหลุมของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line ซึ่งสามารถใช้วิธีการกดทับขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน ปัจจุบันเครื่องฝังส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายขั้นตอน

การตั้งค่าเครื่อง - ขั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 160 - 220 °C
- แรงกด 65 - 130 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

การแบบกดทับหลายครั้ง (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 - 220 °C
- แรงกด 65 - 130N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีแนะนำการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 - 190 °C

ABS 180 - 190 °C

PET 190 - 200 °C

PC 200 - 220 °C

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8414>